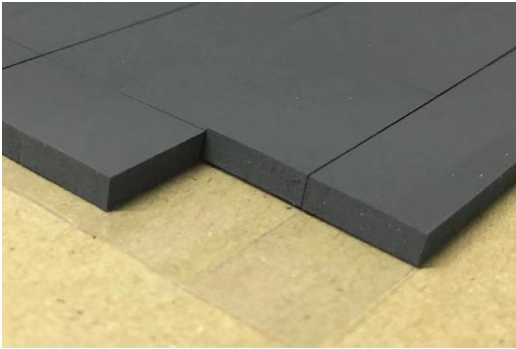


TP300-H55-AM1

导热硅胶垫片

TP300-H55-AM1是同时具备导热和吸波功能的垫片，由硅胶和导热吸波陶瓷填料经过特殊工艺加工而成，具有良好的导热性能、电磁波吸收和电磁屏蔽功能；在导出热量的同时，能吸收泄露的电磁辐射，达到消除电磁干扰的目的，为电子通信产品在导热和电磁屏蔽方面提供良好的解决方案。



特性和优点

- 导热系数3.0W/m·K
- 优秀的电磁屏蔽功能
- 优异的高低温及机械性能
- 化学稳定性高

典型应用

- 电子通讯设备
- 数码产品、计算机
- 医疗电子
- 汽车电子
- 航天航空
- 高频模块

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	灰色	目视
厚度(mm)	1.0~10.0	ASTM D374
反射率(db)	< -5db(2GHz~6GHz)	GJB:2038A-2011
密度(g/cc)	3.8	ASTM D792
硬度(Shore OO)	55	ASTM D2240
重量损失(挥发、渗出, %)	≤1.0	滤纸吸附@压缩25%125°C48H
耐温范围(°C)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(Kv/mm)	≥0.2	ASTM D149
体积电阻率(Ω.cm)	> 10 ¹²	ASTM D257
介电常数@10MHz	≤12.0	ASTM D150
导热性能		
导热系数(W/m-K)	3.0	ISO 22007-2

PS：1、上述保质期主要是建议客户在12月内使用，超出保质期可能导致产品离型力变化，影响装配使用，材质本身不会变质，如超出保质期，只要验证产品的离型力和装配没问题，可无限延期。